

特 許 協 力 条 約

発信人：日本国特許庁（国際調査機関）

あて先 田口 昌浩 様 〒105-0001 日本国 東京都港区虎ノ門三丁目2 5 番2 号 虎ノ門E S ビル8階 ダイヤ特許事務所	<h2 style="margin: 0;">P C T</h2> <p style="margin: 10px 0;">国際調査機関の見解書</p> <p style="margin: 10px 0;">(法施行規則第40条の2) [P C T 規則43の2.1]</p>	
出願人又は代理人の書類記号 PU004574W001	発送日 (日.月.年) 04.02.2020	
国際出願番号 PCT/JP2019/046569	国際出願日 (日.月.年) 28.11.2019	優先日 (日.月.年) 30.11.2018
国際特許分類 (I P C) B32B 27/00(2006.01)i; B32B 27/20(2006.01)i FI: B32B27/00 101; B32B27/20 Z		
出願人 (氏名又は名称) デンカ株式会社		

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の単一性の欠如
- 第V欄 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の欠陥
- 第VIII欄 国際出願についての意見

2. 今後の手続

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	見解書を作成した日 24.01.2020	権限のある職員（特許庁審査官） 塩屋 雅弘 4S 5879 電話番号 03-3581-1101 内線 3472
--	-------------------------	---

第 I 欄

見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

- 出願時の言語による国際出願
 出願時の言語から国際調査のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文（PCT規則12.3(a)及び23.1(b)）

2. この見解書は、PCT規則91の規定により国際調査機関が許可した又は国際調査機関に通知された明らかな誤りの訂正を考慮して作成した（PCT規則43の2.1(b)）。

3. この国際出願で開示されたヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下の配列表に基づき見解書を作成した。

a. 出願時における国際出願の一部を構成する配列表

附属書C/ST.25テキストファイル形式

紙形式又はイメージファイル形式

b. 国際出願とともに、PCT規則13の3.1(a)に基づき国際調査のためにのみ提出された、附属書C/ST.25テキストファイル形式の配列表

c. 国際出願日後に、国際調査のためにのみ提出された配列表

附属書C/ST.25テキストファイル形式（PCT規則13の3.1(a)）

紙形式又はイメージファイル形式（PCT規則13の3.1(b)及びPCT実施細則第713号）

4. さらに、複数の版の配列表又は配列表の写しが提出され、変更後の配列表又は追加の写しに記載された情報が、出願時における配列表と同一である旨、又は出願時における国際出願の開示の範囲を超えない旨の陳述書の提出があった。

5. 補足意見：

第V欄

新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求項	2, 3, 5	有
	請求項	1, 4	無
進歩性 (IS)	請求項		有
	請求項	1-5	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求項	1-5	有
	請求項		無

2. 文献及び説明:

文献1 : WO 2017/150589 A1 (JNC株式会社) 08.09.2017(2017-09-08)
 段落[0001], [0014], [0034]-[0036], [0058]-[0060], [0071], [0072]
 全文, 全図
 & US 2019/0023847 A1, 段落[0001], [0024], [0079]-[0081], [0102]-[0107], [0138]-[0140]
 & EP 3425006 A1 & CN 108699340 A & KR 10-2018-0120218 A
 文献2 : WO 2018/173945 A1 (デンカ株式会社) 27.09.2018(2018-09-27)
 段落[0017], [0054], [0055] & CN 110291848 A
 文献3 : JP 2017-14302 A (パナソニック株式会社) 19.01.2017(2017-01-19) 段落[0001]-[0003]
 ファミリーなし

請求項1、4に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1より新規性、進歩性を有しない。
 文献1には、シルセスキオキシサン ([0014], [0034]-[0036]) 及び無機フィラーを含有する ([0058]) 樹脂組成物を硬化した樹脂組成物層と、当該樹脂組成物層に隣接した基板を有し ([0071])、シルセスキオキシサンと無機フィラーの体積比率が25 : 75である[0060]、積層体が記載されている。ここで、本願の段落[0010]の「シリコーン樹脂としては、オルガノポリシロキサンであり、ケイ素原子に直結したアルケニル基を1分子中に少なくとも2個有する」との記載を鑑みると、引用文献1に記載されたシルセスキオキシサンはシリコーン樹脂であると認められる。また、引用文献1には基板として、ガラス転移点が200℃以上であるポリイミ等が ([0072])、無機フィラーとしてアルミナが、それぞれ例示されている ([0058])。

請求項2、4に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1、2より進歩性を有しない。
 文献2には、金属ベース回路基板に用いる樹脂組成物の発明が記載されており ([0017])、球形度が0.85以上の無機フィラー ([0054]) であって、平均粒子径35~55µmの無機充填剤、平均粒子径20~30µmの無機充填剤、平均粒子径8~18µmの無機充填剤及び0.3~5µmの無機充填剤を含む各種平均粒子径を有するもの ([0055]) を含有することが記載されている。
 文献1と2は共に放熱フィルムの技術分野に属し、熱伝導度を向上するという課題が共通するから、文献1に記載された発明においても文献2に記載された発明を採用することは当業者が容易に想到しえたことである。

請求項3-5に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-3より進歩性を有しない。
 引用文献1に記載されたような放熱シートにおいて熱伝導率を向上させるために基材を構成するバインダー樹脂に無機フィラーを含有させることは、例えば、文献3の段落[0001]-[0003]に記載されているように周知なことである。
 請求項3-5に係る発明は文献1、2に記載された発明及び文献3に記載された様な周知技術から当業者が容易に想到しえたことである。